Partial translation: JP2000-238322A

5

10

15

[0017]In the LED writing head 1 configured as above, the light emitted from the LED light emitter 21 of the surface luminescence LED array 2 is incident direct to the 45-degree right-angle prism 3. The light is reflected on the refection surface 31 that inclines 45 degrees to a upper surface of the supporting substrate 7 of the 45-degree right-angle prism 3, and then incident to the lens 5. The light incident to the lens 5 is condensed by the lens 5 and forms a latent image on the photoconductor Since the light emitted from the surface luminescence LED array 2 is 11. configured so as to be reflected on the surface that inclines 45 degrees to the upper surface of the supporting substrate 7 being in parallel with an optical axis of the LED light emitter 21 of the 45 degree right-angle prism 3 and an optical axis of the lens 5 and then the light is incident to the lens 5, the space between the surface luminescence LED array 2 and the supporting substrate 7 can be approximately the same thickness as that of the lens 5, and the occupied angle $\,lpha\,$ can be determined by a sum of the thickness of the supporting substrate 7, the thickness of the lens 5, and the thickness of the cover 8. Therefore, it is possible to make the occupied angle α for the photoconductor 11 small.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-238322 (P2000-238322A)

(43)公開日 平成12年9月5日(2000.9.5)

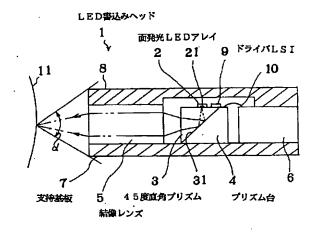
(51) Int.Cl.' 離別記号		F I		
B41J 2/44	L	B41J 3/21	L 2C162	
2/45	5	HO1L 33/00	L 5C051	
2/45	55	H 0 4 N 1/036	A 5F041	
H01L 33/00)			
H04N 1/03	36			
		審査請求 未請求 請求	項の数5 OL (全 8 頁)	
(21)出願番号	特顧平11-41419	(71)出顧人 000006747		
		株式会社リコ	_	
(22)出顧日	平成11年2月19日(1999.2.19)	東京都大田区中馬込1丁目3番6号		
		(72)発明者 大澤 康宏		
		東京都大田区	中馬込1丁目3番6号 株式	
		会社リコー内		
		(74)代理人 100093920		
		弁理士 小島	俊郎	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 LEDアレイ書込みヘッド

(57)【要約】

【課題】感光体に対する占有角を小さくしたLED書込みへッドを得る。

【解決手段】面発光LEDアレイ2のLED発光部21からの光を45度直角プリズム3に直接入射し、45度直角プリズム3の支持基板7の上面に対して45度傾いた反射面で反射して結像レンズ5に入射する。結像レンズ5は入射した光を集光して感光体11に潜像を形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 面発光LEDアレイと45度直角プリズ ムと結像レンズ及び支持基板を有し、

面発光LEDアレイは複数のLEDを有するLED発光 部の発光面を45度直角プリズムの直交する1面に張り 合わされ、45度直角プリズムは直交する2面に対して 45度で形成された反射面が支持基板の上面に対して4 5度の傾きを有するように支持基板に取り付けられ、結 像レンズは光軸を支持基板の上面と平行にして、45度 直角プリズムの面発光LEDアレイを取り付けた面と直 10 交する出射面側の支持基板の先端部に取り付けられてい ることを特徴とするLEDアレイ書込みヘッド。

【請求項2】 上記面発光LEDアレイを、45度直角 プリズムに対して位置決め部材で位置決めして張り合わ せる請求項1記載のLEDアレイ書込みヘッド。

【請求項3】 上記45度直角プリズムに面発光LED アレイとともに面発光LEDアレイの各ドライバLSI を張り合わせた請求項1又は2記載のLEDアレイ書込 みヘッド。

【請求項4】 上記45度直角プリズムと結像レンズの 20 間に、屈折率が45度直角プリズムの屈折率と結像レン ズの屈折率の間にある透明材料を設け、45度直角プリ ズムと結像レンズを透明材料を介して接続した請求項 1、2又は3記載のLEDアレイ書込みヘッド。

【請求項5】 上記45度直角プリズムの面発光LED アレイを張り合わせる面に、LED発光部に対応した部 分を除いた吸収膜を設けた請求項1.2又は3記載のし EDアレイ書込みへッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、複写機やプリン タ装置等で画像の書き込みに使用するLEDアレイ書込 みヘッドに関するものである。

[0002]

【従来の技術】発光ダイオード(LED)を使用したL EDアレイは、電子写真方式のプリンタ装置や複写機な どで画像の書込み用に利用されている。このLEDアレ イを利用したプリンタ装置は、図12に示すように、L EDアレイ41から発した光を結像レンズ42により感 光体11の表面に集光して感光面を露光し潜像を形成す 40 る。このようにLEDアレイ素子を利用したプリンタ装 置は、レーザーラスタ方式のプリンタ装置と比較して振 動や熱による光学系の変形に強い利点を有する。

【0003】また、例えば特開平7-108709号公 報に示されたLEDアレイ書込みヘッドは、図13に示 すように、複数のロッドレンズアレイを配列してハウジ ング43に取り付けられた結像レンズアレイ44の光軸 と面発光型のLEDアレイ41の各LEDの光軸を一致 するようにLEDアレイ41を配置し、結像レンズアレ イ44の入射側に結像レンズアレイ44の各ロッドレン 50 【0009】

ズの配列と同じ配列でロッドレンズの径より小さな径の 複数の穴を有する絞り部材45を配置し、LEDアレイ 41の各LEDからの直接光だけを感光体11に照射 し、感光体11に鮮明で正確な潜像を形成するようにし ている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】近年の電子写真プロセ スを用いた複写機やプリンタ装置は、より高速で高精細 が要求されるとともにカラーに対応でき、小型化や低コ ストであることが望まれている。高速性を確保するため には、書き込み光量を下げないように結像レンズアレイ の光伝達効率が高いことが望まれる。また、高精細であ るためには結像レンズの分解能が確保されていることが 必要である。カラー化には複数の現像ドラムを用いるタ ンデム方式を採用することで対応する場合が多く、小型 化や低コスト化には感光体として小径ドラムを採用する 必要がある。そのためLED書込みヘッドも小型にし、 かつ感光体に対する占有角を減らすことが必要である。

【0005】面発光型のLEDアレイ41からの光を集 光する場合は、LEDアレイ41の基板面を支持基板4 6に貼り合わせることが一般的である。そこで結像レン ズアレイ44は支持基板46に対して垂直方向に配置さ れ、LEDアレイ41からの光を支持基板41と垂直方 向に取り出す。支持基板46にはLEDアレイ41の他 にドライバLS I や周辺回路を搭載することが必要なこ とから、支持基板46の幅を小さくするには限界が生 じ、結果として感光体11に対する占有角αが支持基板 46の大きさで制限されて狭くできないという問題があ る。

【0006】とれに対して特開平8-32110号公報 には感光体に対する占有角を小さくしたLE D書込みへ ッドが示されている。このLED書込みヘッドは、図1 4に示すように、端面発光型のLEDアレイ47を使用 し、端面発光型のLEDアレイ47のpn接合面48と 結像レンズ42の光軸を一致させて円筒状の支持体49 に取り付けて感光体11に接近させるようにしている。 とのLED書込みヘッドは円筒状の支持体49の内径が 結像レンズ42の外径と等しく形成され、円筒状の支持 体49の軸心に沿って光を出射するから、感光体11に 対するLED書込みヘッドの占有角αを小さくすること ができる。

【0007】しかしながら端面発光型のLEDアレイ は、面発光型LEDアレイに比べて製造と実装に手間が かかるため、LED書込みヘッドのコスト上昇の原因に なる。このため面発光型LEDアレイを用いてLED書 込みヘッドを構成することが望ましい。

【0008】この発明はかかる要望を満たすとともに感 光体に対する占有角を小さくしたLED書込みヘッドを 提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】との発明に係るLED書 込みヘッドは、面発光LEDアレイと45度直角プリズ ムと結像レンズ及び支持基板を有し、面発光LEDアレ イは、複数のLEDを有するLED発光部の発光面を4 5度直角プリズムの直交する1面に張り合わされ、45 度直角プリズムは直交する2面に対して45度で形成さ れた反射面が支持基板の上面に対して45度の傾きを有 するように支持基板に取り付けられ、結像レンズは光軸 を支持基板の上面と平行にして、45度直角プリズムの 面発光LEDアレイを取り付けた面と直交する出射面側 10 の支持基板の先端部に取り付けられていることを特徴と する。

【0010】上記面発光LEDアレイを45度直角プリ ズムに対して位置決め部材で位置決めして張り合わせる ことが望ましい。

【0011】また、45度直角プリズムに面発光LED アレイとともに面発光LEDアレイの各ドライバLSI を張り合わせ

【0012】さらに、45度直角プリズムと結像レンズ の間に、屈折率が45度直角プリズムの屈折率と結像レ ンズの屈折率の間にある透明材料を設け、45度直角ブ リズムと結像レンズを透明材料を介して接続すると良

【0013】また、45度直角プリズムの面発光LED アレイを張り合わせる面に、LED発光部に対応した部 分を除いた吸収膜を設けても良い。

[0014]

【発明の実施の形態】との発明のLED書込みヘッドは 面発光LEDアレイと45度直角プリズムとプリズム台 と結像レンズとプリント基板と支持基板及びカバーを有 30 する。面発光LEDアレイは複数のLEDを有するLE D発光部の発光面が45度直角プリズムの直交する1面 に貼り合わされている。45度直角プリズムは直交する 2面に45度で形成された反射面が直角3角柱状に形成 されたプリズム台の傾斜面に貼り合わされ、45度直角 プリズムを張り合わせたプリズム台が支持基板に取り付 けられ、45度直角プリズムの反射面が支持基板の上面 に対して45度の傾きを有する。結像レンズは光軸を支 持基板の上面と平行にして、45度直角プリズムの面発 持基板の先端部に取り付けられている。プリント基板は 支持基板の45度直角プリズムに対して結像レンズとは 反対側に取り付けられている。45度直角プリズムの面 発光LEDアレイを取り付けた面には各LEDを駆動す るドライバLSが取り付けられ、プリント基板とボンデ ィングワイヤで接続されている。

【0015】このLED書込みヘッドの面発光LEDア レイのLED発光部からの光は45度直角プリズムに直 接入射し、45度直角プリズムの支持基板の上面に対し て45度傾いた反射面で反射して結像レンズに入射し、

結像レンズにより集光され感光体に潜像を形成する。 [0016]

【実施例】図1はこの発明の一実施例の構成を示す断面 図である。図に示すように、LED書込みヘッド1は面 発光LEDアレイ2と45度直角プリズム3とプリズム 台4と結像レンズ5とプリント基板6と支持基板7及び カバー8を有する。面発光LEDアレイ2は複数のLE Dを有するLED発光部21の発光面が45度直角プリ ズム3の直交する1面に貼り合わされている。45度直 角プリズム3は直交する2面に45度で形成された反射 面31が直角3角柱状に形成されたプリズム台4の傾斜 面に貼り合わされ、45度直角プリズム3を張り合わせ たプリズム台4が支持基板7に取り付けられ、45度直 角プリズム3の反射面31が支持基板7の上面に対して 45度の傾きを有する。結像レンズ5は光軸を支持基板 7の上面と平行にして、45度直角プリズム3の面発光 LEDアレイ2を取り付けた面と直交する出射面側の支 持基板7の先端部に取り付けられている。プリント基板 6は支持基板の45度直角プリズム3に対して結像レン ズ5とは反対側に取り付けられている。45度直角プリ ズム3の面発光LEDアレイ2を取り付けた面には各し EDを駆動するドライバLSI9が取り付けられ、プリ ント基板6とボンディングワイヤ10で接続されてい る。カバー8は面発光LEDアレイ2等を覆い防塵をす る。

【0017】上記のように構成されたLED書込みへっ ド1の面発光LEDアレイ2のLED発光部21から出 射した光は45度直角プリズム3に直接入射し、45度 直角プリズム3の支持基板7の上面に対して45度傾い た反射面31で反射して結像レンズ5に入射する。結像 レンズ5に入射した光は、結像レンズ5により集光され 感光体11に潜像を形成する。 とのように面発光型LE Dアレイ2から出射した光を、45度直角プリズム3の LED発光部21の光軸及び結像レンズ5の光軸と平行 な支持基板7の上面に対して45度傾いた反射面31で 反射して結像レンズ5に入射するようにしたから、面発 光型LEDアレイ2と支持基板7との距離を結像レンズ 5の厚さと同じ程度にすることができ、感光体11に対 する占有角 αを支持基板 7 の厚さと結像レンズ 5 の厚さ 光LEDアレイを取り付けた面と直交する出射面側の支 40 R及びカバー8の厚さの合計で決定することができ、感光 |体11に対する占有角αを小さくすることができる。

> 【0018】このLED書込みヘッド1の面発光LED アレイ2と45度直角プリズム3とプリズム台4及びド ライバLSI9を有するLEDアレイ光源を製作すると きの製作工程を説明する。

> 【0019】まず、図2の斜視図に示すように、一定厚 さ例えば3mmのガラス基板12に面発光LEDアレイ 2とドライバLSI9の配線に合わせた、フリップチッ プ用配線13を形成する。このフリップチップ用配線1 3は面発光しEDアレイ2のチップとドライバしS19

LEDアレイ2の発光面に位置決め突起16を設け、45度直角プリズム3の面発光LEDアレイ2の貼り合わせ面に、図8に示すように、面発光LEDアレイ2の位置決め突起16に嵌合する位置決め座ぐり17を設けておくことにより、面発光LEDアレイ2を45度直角プリズム3に正確に位置合わせして取付ることができる。したがって感光体11に結像される光点を正確に整列させることができ、良質な画像を書き込むことができる。また、この位置決め突起16と位置決め座ぐり17をフォトリソグラフィーとエッチングにより形成することにより、面発光LEDアレイ2と45度直角プリズム3の位置合わせ精度を数ミクロン程度で実現することができる。

【0023】上記実施例のLED書込みヘッド1は45 度直角プリズム3で反射した光を一定距離隔てた結像レ ンズ5に入射して集光する場合について説明したが、図 9のに示すように、45度直角プリズム3と結像レンズ 5の間に、45度直角プリズム3の屈折率と結像レンズ 5の屈折率の中間の屈折率の光学プラスチックやガラス からなる透明ブロック18を設け、透明ブロック18と 45度直角プリズム3及び透明ブロック18とを光学接 着剤を用いて貼り合わせると良い。例えば45度直角プ リズム3の屈折率が約1.51で、結像レンズ5は軸上 屈折率が1.63の場合、透明ブロック18の屈折率と して1.55を選択する。このように透明ブロック18 の屈折率を45度直角プリズム3の屈折率と結像レンズ 5の屈折率の中間の屈折率にして透明ブロック18の屈 折率を45度直角プリズム3の屈折率と結像レンズ5の 屈折率に近付けているから、45度直角プリズム3と透 明ブロック18の接合面及び透明ブロック18と結像レ ンズ5の接合面における屈折率差に起因した反射を抑制 するととができ、反射によるLED発光部21のゴース ト光が感光体11に入射することを抑制して、良質な画 像を書き込むことができる。また、45度直角プリズム 3と結像レンズ5が透明ブロック18に貼り合わされて 1体化しているから、機械強度を向上することができ、

振動や曲げに対して強くすることができる。
【0024】また、図10に示すように、45度直角プリズム3の面発光LEDアレイ2を取付けた面に、LE D発光部21の部分を除いて吸収膜32を設けると良い。このように面発光LEDアレイ2を取付けた45度直角プリズム3の面にLED発光部21の部分を除いて吸収膜32を設けることにより、LED発光部21から45度直角プリズム3に入射して反射面31で反射した光の一部が45度直角プリズム3の射出面で反射して面発光LEDアレイ2を取付けた45度直角プリズム3の面に拡散して戻ってきても吸収膜32で吸収されて反射しないから、面発光LEDアレイ2を取付けた45度直角プリズム3の面に拡散して戻ってきた光は再び反射して感光体11に入射して不要なフレア光となることを防

をフリップチップ実装技術で実装するために用いられ る。次に、ガラス基板12を、図3(a)に示すよう に、ダイシング加工と研磨により直角と45度に切り出 して45度直角プリズム3を形成し、反射面31に反射 膜としてアルミニウムを蒸着する。また45度の傾斜面 を有するを持つプリズム台4も同様に製作する。その 後、図3(b)に示すように、フリップチップ用配線1 3を有する45度直角プリズム3の反射面とプリズム台 4の傾斜面を貼り合わせる。そして図3に示すように、 45度直角プリズム3のフリップチップ用配線13に合 10 わせて、面発光LEDアレイ2とドライバLSI9をL ED書込みヘッド1の書き込み幅に合わせてフリップチ ップ技術により実装して光源部を作製する。この面発光 LEDアレイ2を45度直角プリズム3に実装すると き、LED発光部21を45度直角プリズム3の張り合 わせ面に向けて実装する。したがってLED発光部21 で発する光は、LED発光部21から直接45度直角プ リズム3に入射する。

【0020】この45度直角プリズム3に実装される面発光LEDアレイ2の発光面を拡大すると、図4に示す 20ように、LED発光部21の並びにボンディングパッド 14が引き出されており、このボンディングパッド14とフリップチップ用配線13が各々1対1に接続され、フリップチップ用配線13でドライバLSI9に接続される。したがってドライバLSI9の配線としては、図5に示すように、信号線と制御線と電源の配線15だけを設ければ良く、LED発光部21の数に比べて少なくてすみ、プリント基板6との接続のための配線数を低減することができる。したがって信号線と制御線と電源の配線15の配線精度が低くて良く、配線15を容易に実 30装することができる。

【0021】とのようにして製作された一定厚さ例えば 3mmの45度直角プリズム3を貼り付た厚さが例えば 3mmとプリズム台4と、一定厚さ例えば3mmの結像 レンズ5及びプリント基板6を一定厚さ例えば2mmの アルミニウム製の支持基板7に取り付け、ドライバLS 19から外部に引き出される配線15を、図6に示すよ ろに、ボンディングワイヤ10を介してプリント基板6 に接続する。このプリント基板6は外部と接続される。 とのボンディングワイヤ10の配線数はLED発光部2 1の数に比べて十分少ないので、ボンディングワイヤ1 0の実装を容易に行うことができる。また、45度直角 プリズム3を貼り付たプリズム台4と結像レンズ5の厚 さを例えば3mmとし、支持基板7とカバー8の厚さを 例えば2mmとすると、LED書込ヘッド1の厚さは7 mmとなり、従来の面発光LED書込ヘッドと比べて1 /3以下の厚さにすることができ、感光対11に対する 占有角αを非常に小さくすることができる。

【0022】また、45度直角プリズム3に面発光LE 角プリズム3の面に拡散して戻ってきた光は再び反射し Dアレイ2を貼付るときに、図7に示すように、面発光 50 て感光体11に入射して不要なフレア光となることを防

ぐことができる。

【0025】この吸収膜32を有する45度直角プリズム3を作製する製作工程は、図11(a)に示すように、45度直角プリズムを製作するガラス基板12にあらかじめクロムと酸化クロムの多層構造による吸収膜32を一定厚さ例えば300nmの厚さで蒸着しておく。次に、図11(b)に示すように、LED発光部21の大きさ例えば10μmより1回り大きい例えばW=20μmの幅Wのストライブで吸収膜32を選択エッチングし、その表面をを一定厚さ例えば300nmの厚さのS10iの絶縁膜33で被覆する。その後、図11(c)に示すように、フリッチチップ用配線13を形成してからダイシング加工と研磨によりガラス基板12を切り出して45度直角プリズム3とする。このようにして吸収膜32を有する45度直角プリズム3を精度良く作製することができる。

[0026]

【発明の効果】との発明は以上説明したように、面発光 LEDアレイのLED発光部からの光は45度直角プリズムに直接入射し、45度直角プリズムの支持基板の上 20 面に対して45度傾いた反射面で反射して結像レンズに 入射し、結像レンズにより集光され感光体に潜像を形成 するようにしたから、面発光型LEDアレイを使用した LEDアレイ書込みヘッドを薄くすることができ、感光 体に対する占有角を小さくすることができる。

【0027】また、面発光LEDアレイを45度直角プリズムに対して位置決め部材で位置決めして張り合わせることにより、面発光LEDアレイを45度直角プリズムに正確に位置合わせして取付ることができ、感光体に結像される光点を正確に整列させて良質な画像を書き込 30むことができる。

【0028】さらに、45度直角プリズムに面発光LEDアレイとともに面発光LEDアレイの各ドライバLSIを張り合わせることにより、面発光LEDアレイと各ドライバLSIの接続を容易にすることができるとともに外部配線の本数を低減して容易に配線を行うことができる。

【0029】また、45度直角プリズムと結像レンズの間に、屈折率が45度直角プリズムの屈折率と結像レンズの屈折率の間にある透明材料を設け、45度直角プリ 40ズムと結像レンズを透明材料を介して接続することにより、45度直角プリズムの出射面のおける反射等を抑制し、反射によるLED発光部のゴースト光が感光体に入射することを防ぎ、良質な画像を書き込むことができ

る か、レ牡梅リンノフ

る。また、45度直角プリズムと結像レンズが透明プロックを介して1体化されているから、LEDアレイ書込みヘッドの機械強度を向上することができる。

【0030】また、45度直角プリズムの面発光LED アレイを張り合わせる面に、LED発光部に対応した部分を除いた吸収膜を設け、吸収膜で45度直角プリズムの出射面における反射光を吸収することにより、反射によるLED発光部のゴースト光が感光体に入射することを防ぎ、良質な画像を書き込むことができる。

0 【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施例の構成を示す断面図である。

【図2】45度直角プリズムを作製するガラス基板の斜 視図である。

【図3】面発光LEDアレイと45度直角プリズムを有する光源の作製工程図である。

【図4】面発光LEDアレイの発光面を拡大した斜視図である。

【図5】ドライバLSIの配線を示す斜視図である。

【図6】プリント基板との接続を示す上面図である。

【図7】面発光LEDアレイの位置決め突起を有する発 光面を示す斜視図である。

【図8】位置決め座ぐりを有する45度直角プリズムを示す斜視図である。

【図9】45度直角プリズムと結像レンズの間に透明ブロックを設けた実施例の構成図である。

【図10】45度直角プリズムに吸収膜を設けた実施例の構成図である。

【図11】吸収膜を有する45度直角プリズムの作製工 程図である。

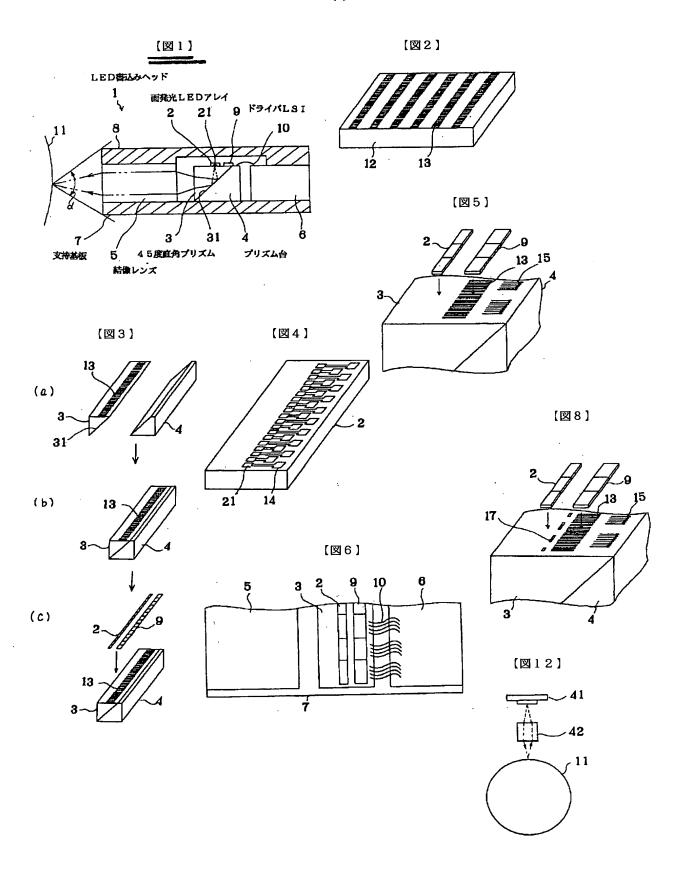
80 【図12】LEDアレイを使用した書込みヘッドの説明 図である。

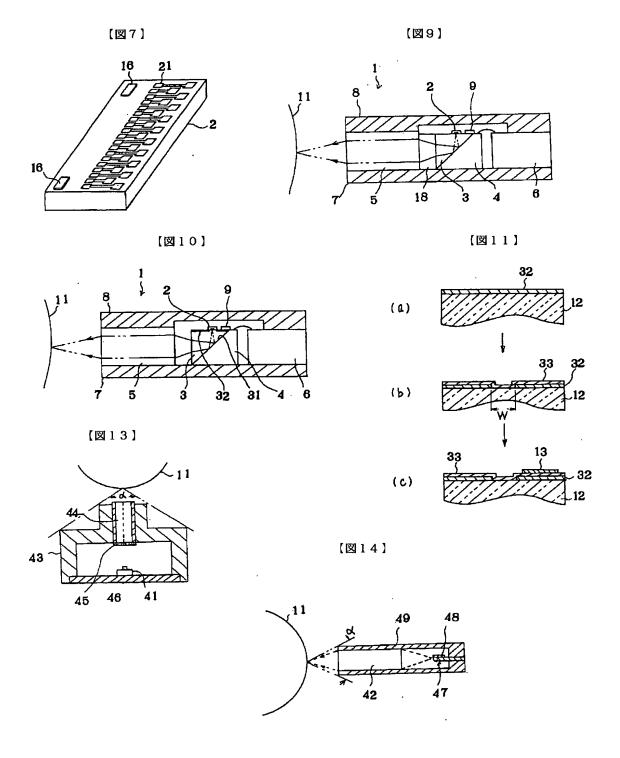
【図13】従来例の構成図である。

【図14】他の従来例の構成図である。

【符号の説明】

- 1 LED書込みヘッド
- 2 面発光LEDアレイ
- 3 45度直角プリズム
- 4 プリズム台
- 5 結像レンズ
- 6 ブリント基板
 - 7 支持基板
 - 8 カバー
 - 9 ドライバLSI
 - 10 ボンディングワイヤ





フロントページの続き

Fターム(参考) 2C162 FA17 FA23 FA44 FA49

5C051 AA02 CA08 DA03 DB02 DB04

DB06 DB22 DB24 DB29 DC02

DC03 DC04 DC07 DD02

5F041 AA47 CA12 CB22 DA09 DA20

DA83 DB07 EE11 EE23 EE25

FF13